

產品說明書

WS3401 晶片助焊劑

特點

- 可溶于水
- 經過多次迴焊/清洗後無殘留物
- 保持錫球凸塊形狀均勻
- 不含鹵化物
- 適用於錫鉛, 無鉛和高溫焊接
- 對錫球凸塊下的金屬化表面無侵蝕作用

簡介

WS-3401型晶片助焊劑能將晶片上錫球凸塊表面的氧化物清除掉。在焊料本身的表面張力作用下, 它能均勻地覆蓋在半球形錫球凸塊上, 不會侵蝕焊點, 也不會出現錫橋。由於它的流變特性, 可以用旋轉或者用噴霧的方法進行塗敷。

特性

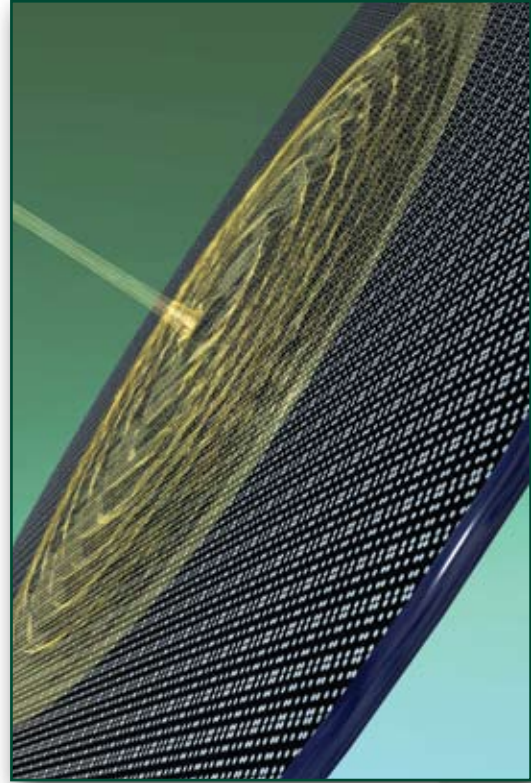
特性	測試值	測試方法
助焊劑類型	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650)
典型粘度	45cst	Brookfield
表面絕緣電阻 (歐姆, 清洗後)	合格(在溫度為 85°C、相對濕度為85%的條件下, 7天以後>109)	IPC-B-24
典型酸度值	68mg KOH/g	滴定
色澤	介於琥珀色與褐色之間	目視觀察
保質期	6個月	0°C到+25°C

所有信息僅供參考。不用作產品的規範。

使用

旋轉式塗敷: 先用某一個轉速將液態助焊劑均勻地覆蓋在晶片表面, 然後再用很高的旋轉速度(大約 2000rpm)將助焊劑打薄, 把晶片表面上多餘的助焊劑去掉。

噴霧式塗敷: 噴霧器中的助焊劑儲存罐應當貯有足夠8小時的用量。罐內剩餘的助焊劑如果存放時間過長會失效(在室溫下可在罐內存放8小時以上)。噴霧器需要經常清洗, 才能有效地保證這種助焊劑或其他助焊劑的純淨度。



清洗

用室溫或高於室溫的去離子水或者使用加了清洗劑的水在高於60psi的壓力下清洗1分鐘以上。

包裝

100克到3.8公升(1加侖)罐裝。可根據具體要求提供其他規格的包裝。

接反面→

編號 98357(TC A4) R0

www.indium.com

china@indium.com

亞洲: 新加坡: +65 6268 8678

中國: 蘇州、深圳、柳州: +86 (0)512 628 34900

歐洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美國: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900



經
ISO 9001
注册

WS3401 晶片助焊劑

儲存

WS-3401存放在溫度為0-25°C時, 保質期可以達到最長。在超過25°C的環境裏存放時間不可以超過4天, 儲藏溫度不可以超過30°C。WS3401從冷藏環境移到室溫後, 在使用前應在室溫下放置至少4小時。

技術支持

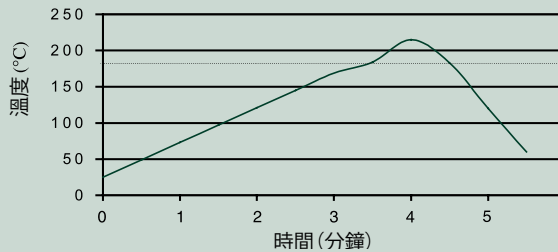
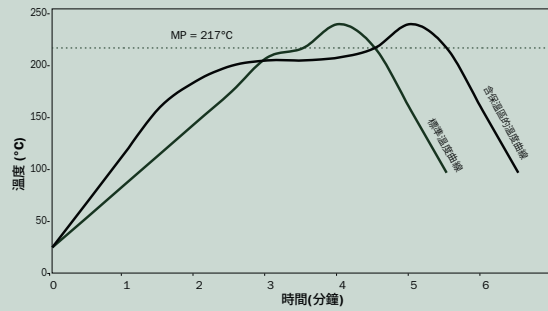
在迅速答覆全球客戶和現場技術支持方面, 鋼泰公司在產業界中樹立了榜樣。鋼泰公司的技術支持工程師隊伍能夠提供材料科學和半導體封裝工藝應用的各方面的專業知識。

材料安全資料

關於本產品的材料安全資料 (MSDS), 請上網查閱。
網址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

迴焊

建議使用的溫度曲線:



在空氣或氮氣 (氧氣含量<100ppm) 中進行迴焊時, 溫度先直線上升到比液相線溫度高30°C, 迴焊的最高溫度應 <340°C。建議用戶從這些溫度曲線開始, 根據製程的需要對它進行優化。

此產品說明書只提供一般性資訊。不能保證或擔保這些資訊所述產品的性能, 也不可以把這些資訊看作是對所述產品的保證

或擔保。售出的產品只承諾隨產品包裝及發票所附的書面保證及有關的限制條件。

www.indium.com

china@indium.com

亞洲: 新加坡: +65 6268 8678

中國: 蘇州、深圳、柳州: +86 (0)512 628 34900

歐洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美國: Utica, Clinton, Chicago: +1 315 853 4900



經
ISO 9001
註冊